

2021年度(2022年3月期) 決算概要について



Brightening the Future
Since 1946

2021年度 通期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2022年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益	11
設備投資額・減価償却費・研究開発費	13

配当について	14
--------	----

決算概況

(単位：億円)

	2020年度 通期	2021年度 通期	前年度比	
				増減率
売上高	1,881	2,719	+ 839	45%
営業利益 (営業利益率)	233 (12%)	714 (26%)	+ 481	206%
経常利益 (経常利益率)	265 (14%)	758 (27%)	+ 493	186%
純利益※ (純利益率※)	180 (10%)	526 (19%)	+ 346	192%

※親会社株主に帰属する純利益

1株当たり純利益	133.38円	389.58円
----------	---------	---------

成長市場向け設備投資による生産能力増強等が寄与し、大きく業績が伸長。売上高、利益とも過去最高を記録。

売上高：フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの需要拡大ならびに生産体制強化により売上が大幅に増加。リードフレームは、自動車向けをはじめとして大幅な増収。半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、好調な半導体市場を背景に売上が大きく増加し、ハイエンドスマートフォン向けにI C組立の受注が大幅に増加。これらにより前期比45%増と大きく増加。

損 益：旺盛な需要を背景とする各製品の売上増加に伴う収益性の向上や、為替相場において円安基調が継続したことなどにより、前期比大幅な増益。

セグメント別売上高・経常利益

(単位：億円)

セグメント		2020年度		2021年度		前年同期比 増減率 (%)
売上高 ※1			構成比(%)		構成比(%)	
	プラスチックパッケージ	1,133	(60)	1,694	(62)	49
	メタルパッケージ	664	(35)	929	(34)	40
	その他	83	(5)	96	(4)	16
	合計	1,881	(100)	2,719	(100)	45
経常利益 ※2			利益率(%)		利益率(%)	
	プラスチックパッケージ	170	(15)	509	(30)	199
	メタルパッケージ	91	(14)	235	(25)	158
	その他/調整額	4		14		
	合計	265	(14)	758	(28)	186

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

参考情報

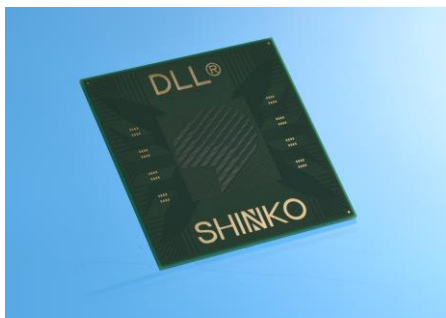
(単位：億円)

	2020年度	2021年度
総 資 産	2,410	3,195
純 資 産	1,534	2,020
自己資本比率	64%	63%

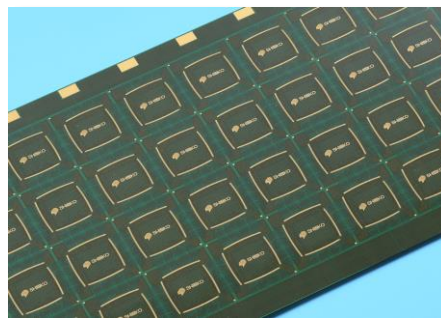
設備投資額 ※	301	575
減価償却費 ※	174	300
研究開発費	30	35
為替レート(1米ドル)	105円	111円

※ 無形固定資産を除く

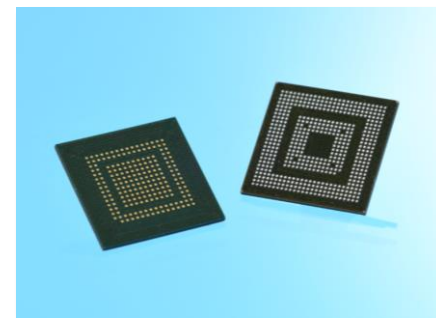
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

プラスチックパッケージ

（単位：億円）

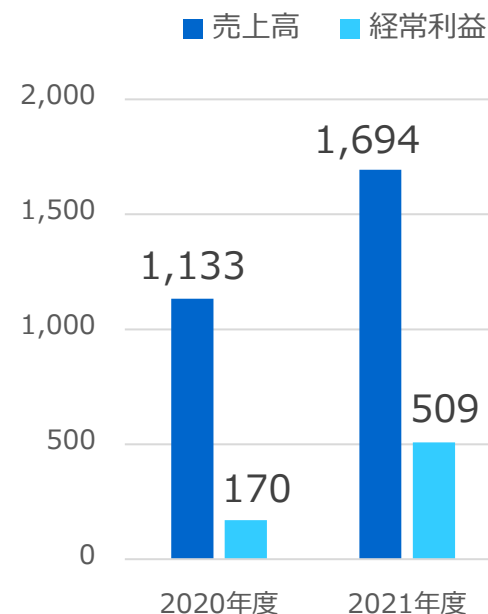
	2020年度	2021年度	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	1,133 (60%)	1,694 (62%)	+561	49%
経常利益（利益率）	170 (15%)	509 (30%)	+339	199%

<売上高>

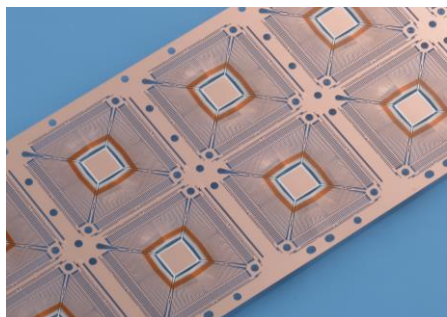
- フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けに需要が拡大する中において生産能力増強が寄与したことなどにより、売上が大幅に増加
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けに受注が大きく増加
- プラスチックBGA基板は、先端メモリーや自動車向けの受注が拡大し、増収

<損益>

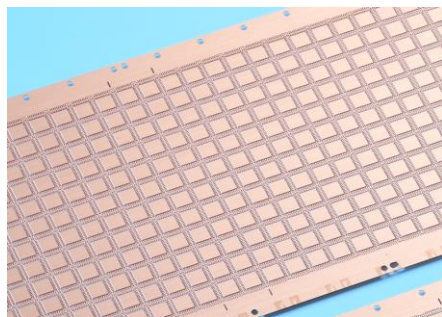
- フリップチップタイプパッケージの売上が高付加価値製品をはじめ大きく増加し、為替相場において円安基調が継続したことなどにより、大幅増益



メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

メタルパッケージ

（単位：億円）

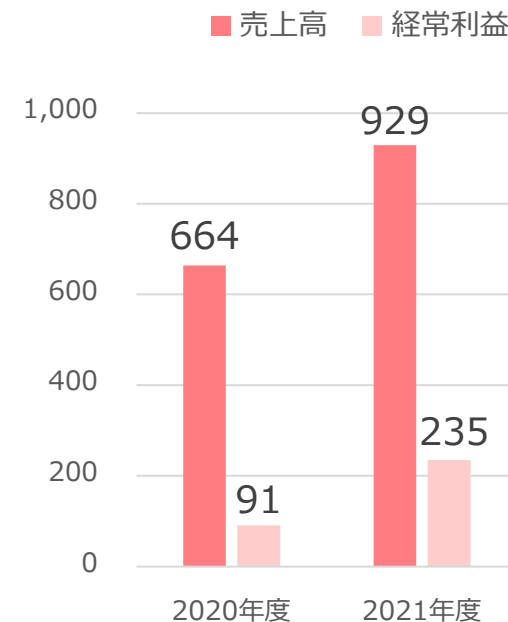
	2020年度	2021年度	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	664 (35%)	929 (34%)	+265	40%
経常利益（利益率）	91 (14%)	235 (25%)	+144	158%

<売上高>

- リードフレームは、自動車市場向けが好調に推移したことに加え、幅広い用途において需要が増加したことを背景に大幅な増収
- セラミック静電チャックは、引き続き半導体製造装置市場における旺盛な需要に支えられ売上が大きく増加
- ガラス端子は、光学機器向けの受注が増加
- CPU向けヒートスプレッダーは、増収

<損益>

- リードフレーム、セラミック静電チャックの増収効果および為替相場において円安基調が継続したことなどにより、大幅増益



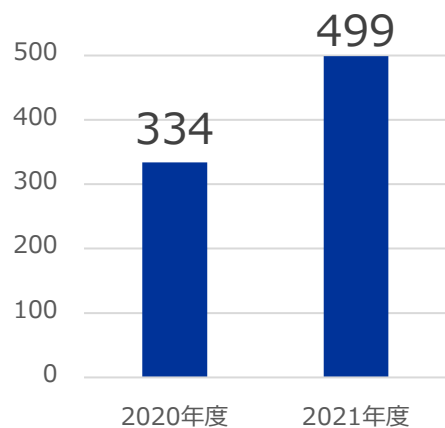
部門別売上高

(単位：億円)

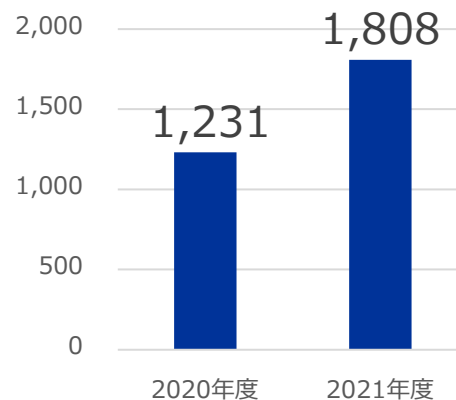
部 門	2020年度	2021年度	前年同期比	
			増減率	
I C リードフレーム	334 (18%)	499 (18%)	+165	49%
I C パッケージ	1,231 (65%)	1,808 (67%)	+576	47%
気 密 部 品	314 (17%)	412 (15%)	+98	31%

※ () は構成比

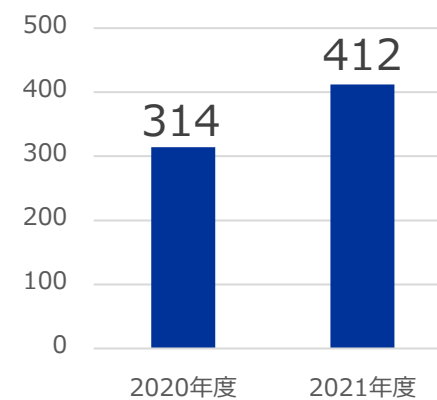
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



売上高・損益

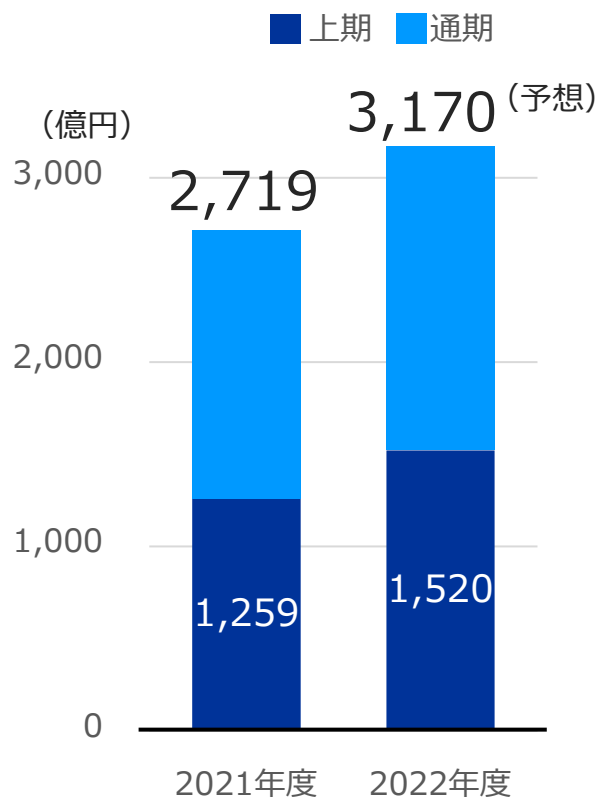
(単位：億円)

	2021年度 (実績)			2022年度 (予想)			前年度比	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期		増減率
売上高	1,259	1,460	2,719	1,520	1,650	3,170	+451	17%
営業利益 (営業利益率)	301 (24%)	413 (28%)	714 (26%)	400 (26%)	450 (27%)	850 (27%)	+136	19%
経常利益 (経常利益率)	316 (25%)	443 (30%)	758 (28%)	400 (26%)	450 (27%)	850 (27%)	+92	12%
純利益※ (当期純利益率※1)	217 (17%)	309 (21%)	526 (19%)	280 (18%)	310 (19%)	590 (19%)	+64	12%
為替レート	111円/\$			118円/\$				

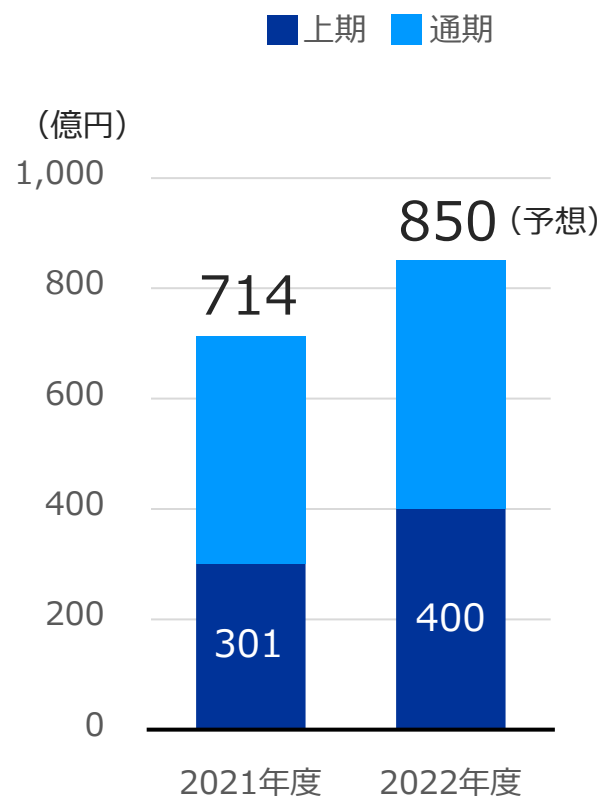
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2022年度 通期の見通し (連結)

売上高

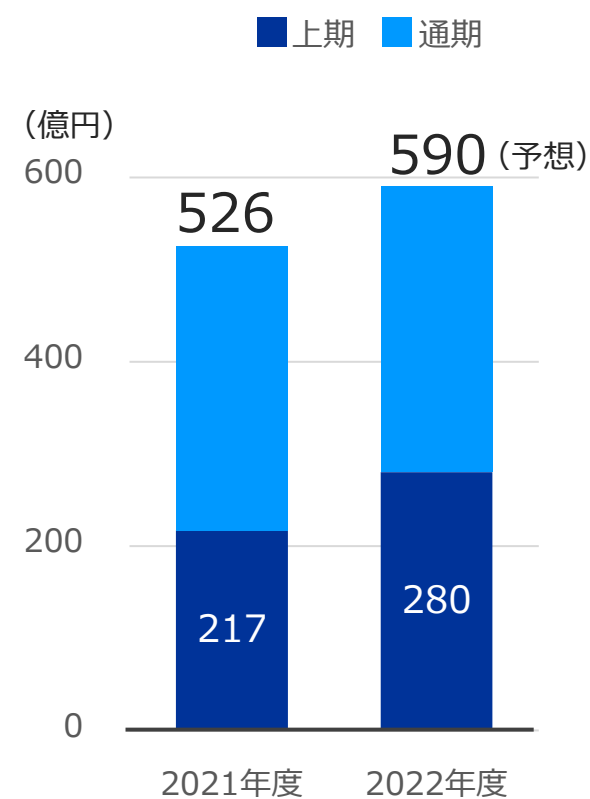


営業利益

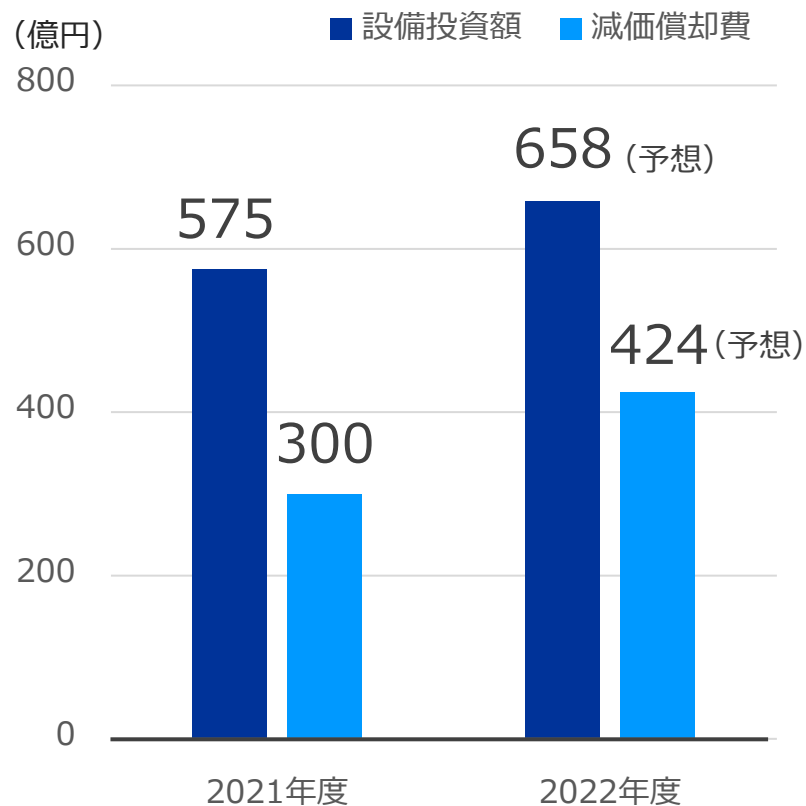


純利益※

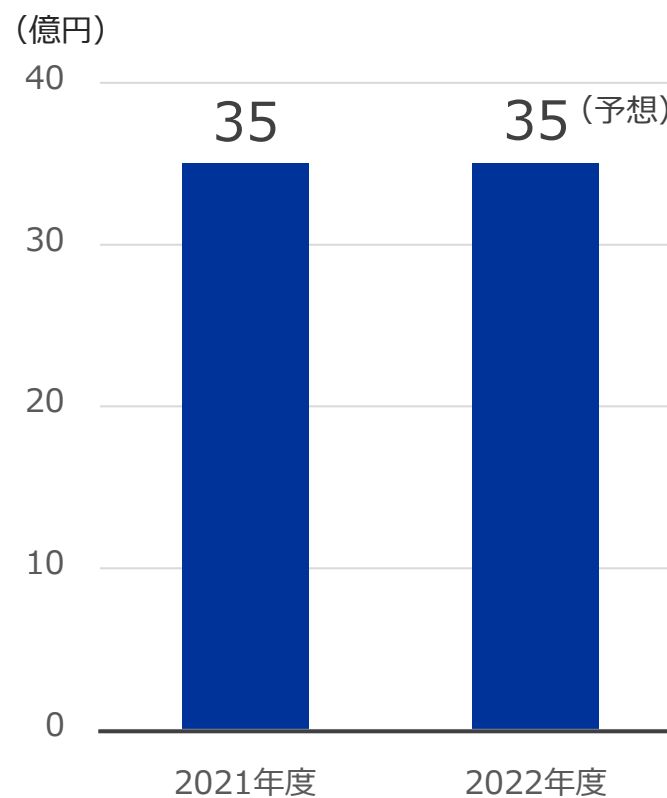
※親会社株主に帰属する当期純利益



設備投資額・減価償却費

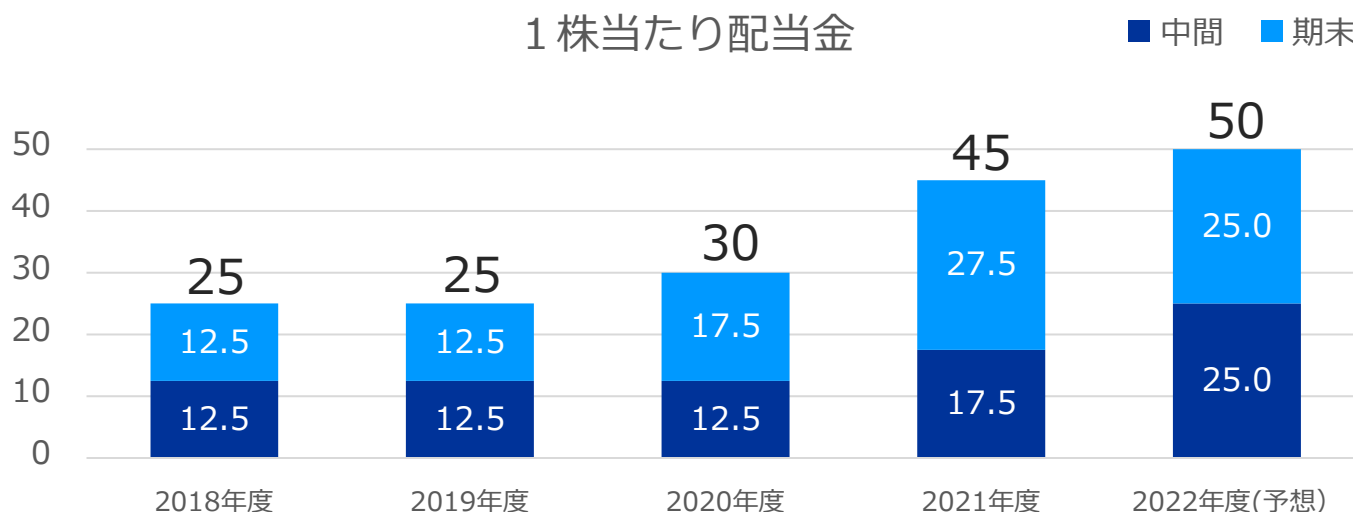


研究開発費



- 2021年度**
- ・ 中間配当：17円50銭
 - ・ 期末配当：27円50銭
 - ・ 年間45円（前期比15円増配・配当性向11.6%）

- 2022年度
（予想）**
- ・ 中間配当：25円
 - ・ 期末配当：25円
 - ・ 年間50円（前期比5円増配・配当性向11.4%）



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。